

## 回路基板材料「エスパネックス」 九州製造所における新工場の建設、 台湾での委託生産および海外新支店の設置を決定

当社（社長：西 恒美）は、現在、電子材料事業部木更津製造所（千葉県木更津市）において増強工事を進めている、回路基板材料事業の主力商品であるフレキシブルプリント基板用無接着剤銅張積層板（2層CCL）「商品名：エスパネックス」について、今後さらに需要の増加が見込まれ、平成17年度において大幅な供給不足となる見通しであることから、九州製造所（福岡県北九州市）構内での新工場建設を決定いたしました。

さらに、現在の供給能力不足の早期解消と、市場の拡大が進む台湾や中国におけるシェア拡大を図るため、台湾の加工メーカー・Crest technology co.,Ltd.（本社・工場：新竹工業区）に「エスパネックス」の硬化工程を委託することといたしました。

木更津製造所で塗工した半製品を Crest technology 社へ持ち込み、最終製品に加工して台湾をはじめとする市場へ供給するもので、平成16年2月からの営業運転開始（年産35万㎡）を予定しています。

また、「エスパネックス」の成長を支える携帯電話の高機能化・高精彩化は、日本国内にとどまらず、2層CCLの市場は韓国、台湾、中国、欧米等、世界的な広がりを見せていることから、現地におけるお客さまへの営業・技術面でのサービス向上を図るため、平成16年1月1日付で韓国に「ソウル江南支店」、台湾に「台北支店」を、さらに今後のマーケット開拓を目的に、中国に「上海事務所」をそれぞれ設置することといたしました。

「エスパネックス」は、現在、年産能力300万㎡の木更津製造所において、およそ50億円を投資して、第四系列（平成16年2月営業運転開始）、および第五系列（平成16年4月営業運転開始）の建設工事を進めており、これらをあわせた年産能力は550万㎡となりますが、2層CCLの市場は、高機能化（カメラ搭載、動画化対応、画面の高精彩化等）が進む携帯電話を中心とするデジタル機器の小型軽量化、高性能化に伴う回路基板の高密度実装化、微細加工化に不可欠な材料として拡大を続け、なかでも、品質・性能に優れる「エスパネックス」へ需要が集中しており、今後ともさらに需要の増加が見込まれることから、新工場の建設を決定したものです。

このたび建設を決めた新工場は、第六系列（年産150万㎡）および、第七系列（同）の二系列に対応するもので、これらをあわせた木更津・九州の総年産能力は850万㎡となります。

営業運転開始は、第六系列が平成17年7月、第七系列が同年10月を予定しており、第七系列については、再度需給動向を確認した上で正式決定いたします。二系列をあわせた総投資額はおよそ50億円程度を見込んでいます。

また、今回の新工場建設によって、現在の木更津製造所一拠点での生産体制から、複数拠点による安定供給体制が確立されることから、災害などによるリスク回避を図ることも可能となりました。

当社電子材料事業部では、主力の「エスパネックス」について、成長著しい2層CCLの世界市場で過半数のシェアを維持・拡大し、デファクトスタンダードの地位を確固たるものにするとともに、有機EL材料や液晶関連材料、高耐熱プラスチック基板などの「フラットパネルディスプレイ材料」、次世代型実装材料や絶縁材料など「半導体関連材料」についても、今後ともさらなる事業基盤の拡充を目指してまいります。

### 「エスパネックス」年産能力の推移

平成元年～	販売開始		
～平成14年5月	第二系列まで稼働	120万㎡/年	
平成14年6月	第三系列営業運転開始	180万㎡/年	
平成15年5月	新硬化プロセス稼働	300万㎡/年	
平成16年2月	第四系列営業運転開始	400万㎡/年	<建設中>
平成16年4月	第五系列営業運転開始	550万㎡/年	<建設中>
平成17年7月	第六系列営業運転開始	700万㎡/年	<新設決定>
平成17年10月	第七系列営業運転開始	850万㎡/年	<計画中>
平成16年2月	台湾・Crest technology 社委託生産開始	35万㎡/年	

以上

本件に関するお問い合わせは、

新日鐵化学株式会社 経営企画本部総務部（広報）

：03（5759）2741まで